

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股东大会召开日期。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年3月30日